

## INVESTOR RELATIONS

20년 상반기 (1H 20)

Your Most trustworthy



## 유의사항 [Disclaimer]

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

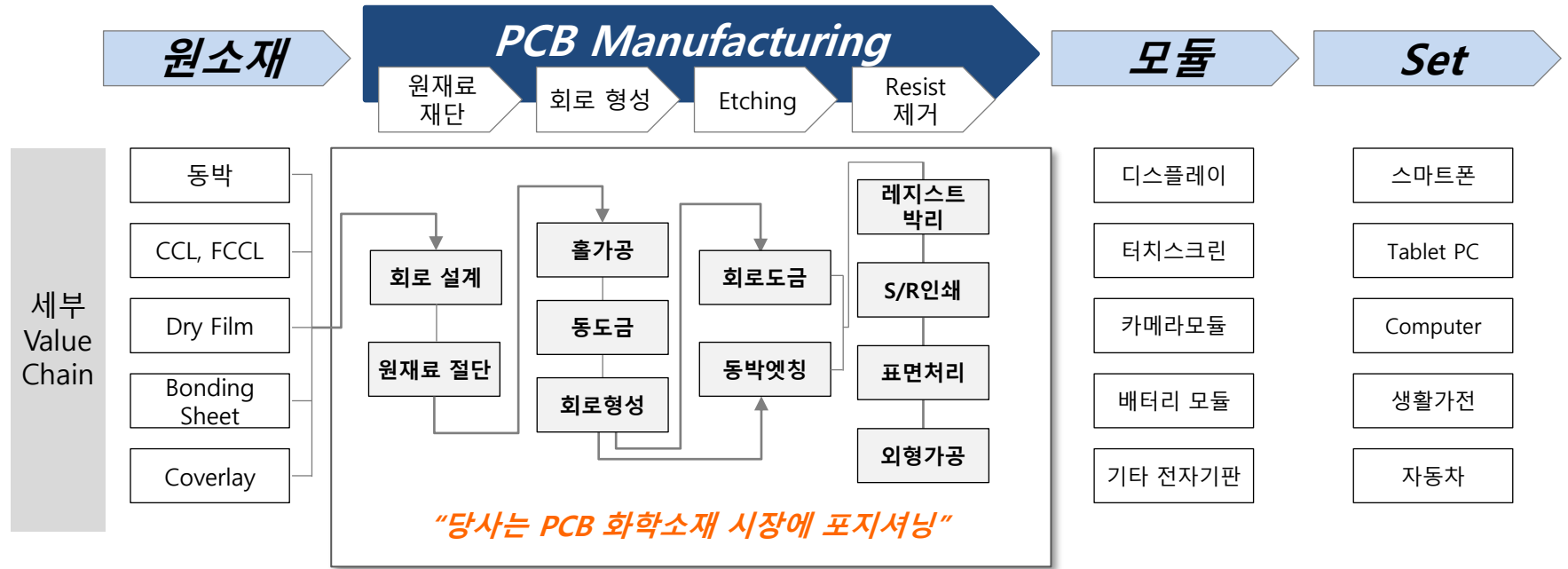
또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.



PCB Industry value chain



당사의 주요 포지셔닝은 PCB 화학소재이며 특히 부가가치가 높은 최종표면처리 및 화학동도금 Segment에서 주요 매출이 발생되고 있습니다.

주요고객사 (Major Customer)

*“주로 한국, 중국, 대만의 FPCB 회사들이 주요 고객사이며, 최근 한국의 PKG Substrate 제조사로 고객사 확대중”*

|                  |  |
|------------------|--|
| FPCB<br>Customer |     |
|                  |      |
|                  |     |
| PKG<br>Substrate |     |

## Global YMT



- ✓ 전체 종업원 수 : 340명
  - 한국 : 240명
  - 중국 & 대만 : 40명
  - 베트남 : 60명

### YMT Co.,Ltd. (KOREA, Head Quarter)

- Incheon, Korea.
- Chemical Division, Materials Division.
- 3 Factories in Nam-Dong Industry area.
- **2 R&D Center.**
- Main Manufacturing location

### YMT Co.,Ltd. Taiwan Branch

- Taoyuan, Taiwan
- Sales and Promotion for Chinese and Taiwanese customer

### YMT China (Shenzhen) Co.,Ltd.

- Shenzhen, China
- 2 Branches : Pinhong, Kunshan Branch
- Constructing Factory in Zhuhai (Pinhong, Branch)

### YMT Vina Co.,Ltd.

- Bac-ninh, Vietnam
- Chemical Division, Plating outsourcing
- Vin-Phuc Branch : Manufacturing Location.

### YPT Co.,Ltd.

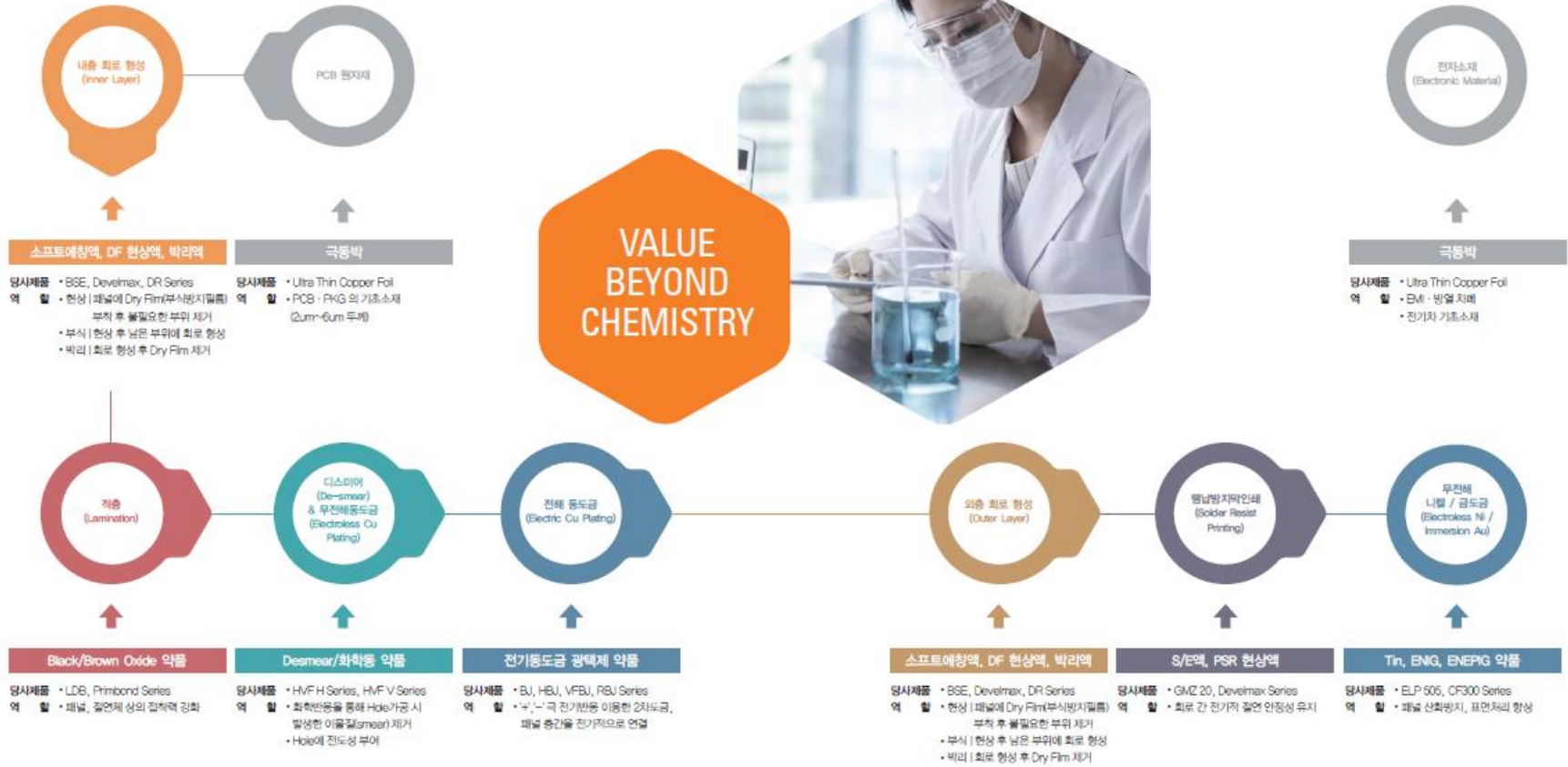
- Ansan, Korea
- Plating Outsourcing : ENIG, ENEPIG, Via-Fill
- R&D Center

### Beyond Solution

- Ansan, Korea
- Plating Machine R&D
- Equipment management service

# TOTAL SOLUTION FOR ELECTRONIC MARKET

PCB / 반도체 / 전자재료 Processing 전반을 아우르는 Chemical & Material Technology, 와이엠티가 이끌어 가고 있습니다



## Total Solution for Customer

와이엠티는 공정의 첫 단계인 세정, 박리제 부터 최종 표면처리 까지의 모든 화학소재 기술을 보유하고 있습니다. 이에 저희는 고객사 설비 특성에 맞는 Total chemical solution을 제공하고 있습니다.



### Final Finishing Chemical

#### **Soft ENIG Process**

- ✓ CF 300 Series
- ✓ MIKO Series

#### **ENIG Process**

- ✓ PEN Series
- ✓ MIKO Series

#### **ENEPIG Process**

- ✓ PEN Series
- ✓ ELP or ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

#### **EPIG process**

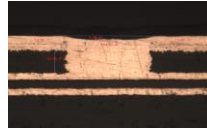
- ✓ ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

#### **Immersion process**

- ✓ PROTIN Series

#### **Electrolytic gold process**

- ✓ HG 300 series
- ✓ SAU 10 series



### Copper plating chemical

#### **Electroless Copper plating**

- ✓ HVF Series
- ✓ MJH series

#### **Electrolytic Copper plating**

- ✓ BJ series
- ✓ HBJ Series(Half-fill)
- ✓ FSBJ Series(flash plating)
- ✓ ZEUS Series(Via-fill)



### Process Chemical

#### **DES Chemical**

- ✓ MSAP/SAP DFR Stripper
- ✓ MSAP/SAP Cu seed Etchant
- ✓ GMZ Series
- ✓ HWA Series

#### **Cleaner**

- ✓ FXC Series
- ✓ EQ Series

#### **Gold Recover**

#### **UBM Etchant**

#### **LAZ Process**



### New product for 5G

#### **No etching and roughness laminating pretreatment**

#### **Ultra low profile detachable thin copper foil**

#### **Positive Cu roughening**

#### **Process Nanotus®**

#### **Electroless Copper plating for LCP**

최종표면처리

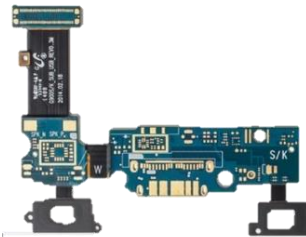
동도금

Process Chemical

Electronic Materials

구리 산화 방지 및 기판 표면을 보호하기 위한 최종 표면처리 프로세스로  
당사의 금도금 프로세스 소재는 세계 최고수준의 기술력을 보유하고 있습니다.

Soft ENIG Process



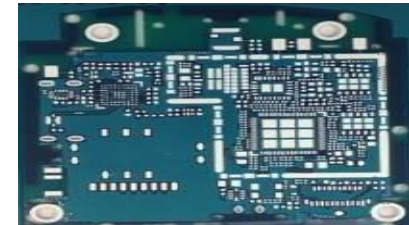
- ✓ 우수한 내 절곡성으로 Nickel Crack 문제 해소
- ✓ 니켈 부식 최소화
- ✓ 미세회로구현에 적합
- ✓ FPCB & RFPCB 높은 점유율 확보 중

ENEPIG Process



- ✓ Wire-bonding 과 Soldering 동시에 만족  
→ 카메라 등 모듈에 적합
- ✓ Etch Back 공정이 필요 없는 무전해 도금
- ✓ 금도금 편차 최소화
- ✓ 공정의 안정성 우수

Other Finish Plating



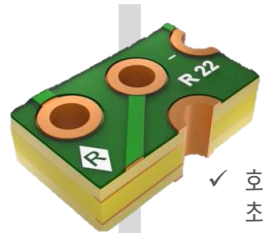
ENIG / Silver / Tin Plating

- ✓ 우수한 Solderability 확보
- ✓ 공정 단순화
- ✓ 외관문제 없음 (변색 등)
- ✓ 굴곡성 우수
- ✓ Cost 경쟁력 우수

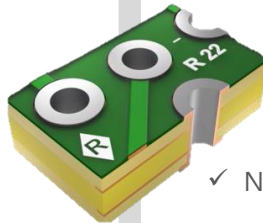


# Products Introduction – Finish Plating

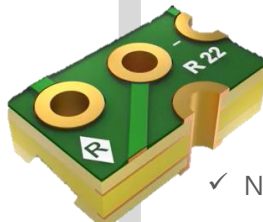
## 최종표면처리



✓ 회로형성, 적층 등 최종단계의 기판



✓ Nickel 도금



✓ Nickel위에 금도금

## 동도금

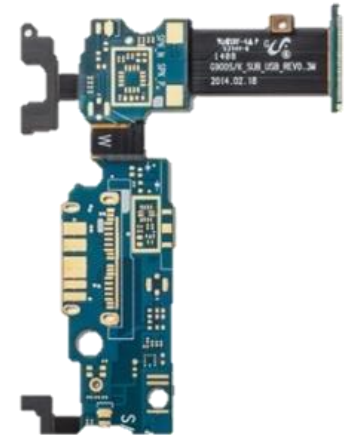


- ✓ 수세, 소프트에칭, 프리딤 등 여러 프로세스를 거쳐 최종적으로 구리-니켈-금 순서로 도금을 진행
- ✓ 와이엠티는 금이 도금될 수 있는 약품, 첨가제들을 고객사로 납품하고 있음 [금은 PCB 제조사에서 직접 구매 진행]

## Process Chemical

## Electronic Materials

### 금도금 후 최종기판



최종표면처리

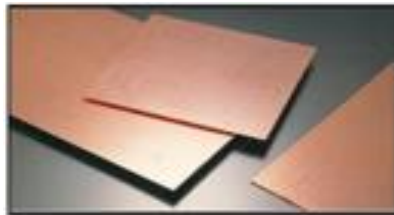
동도금

Process Chemical

Electronic Materials

드릴을 통해 가공된 홀을 구리 도금을 통해 층간 전기적 연결을 얻어내는 공정  
화학동도금, 전기동 분야에서 외산과 경쟁중으로 독자적인 기술력 보유

Electroless copper plating



- ✓ 부도체 물질에 화학적 전도성을 부여하는 공정
- ✓ Pd 이온을 금속이온으로 환원 시켜 무전해 도금진행
- ✓ 타사대비 품질경쟁력 및 Cost 경쟁력 우수
- ✓ 자사 설비 보유를 통한 다수의 양산 Data 확보

Electrolytic copper plating



- ✓ 동의 석출로 원하는 동 두께를 도금 하는 공정
- ✓ 원하는 위치와 두께를 형성하기에 적합
- ✓ 타사대비 도금두께 균일성 유지력 뛰어남
- ✓ 높은 수율로 가격 경쟁력 유리

Plastic copper plating



- ✓ 부도체 물질에 화학적 전도성을 부여하는 공정
- ✓ Pd 이온을 금속이온으로 환원 시켜 무전해 도금진행
- ✓ 밀착력 확보 및 원하는 부위에 화학 도금 진행 가능
- ✓ IT 내장형 안테나 용도로 활용

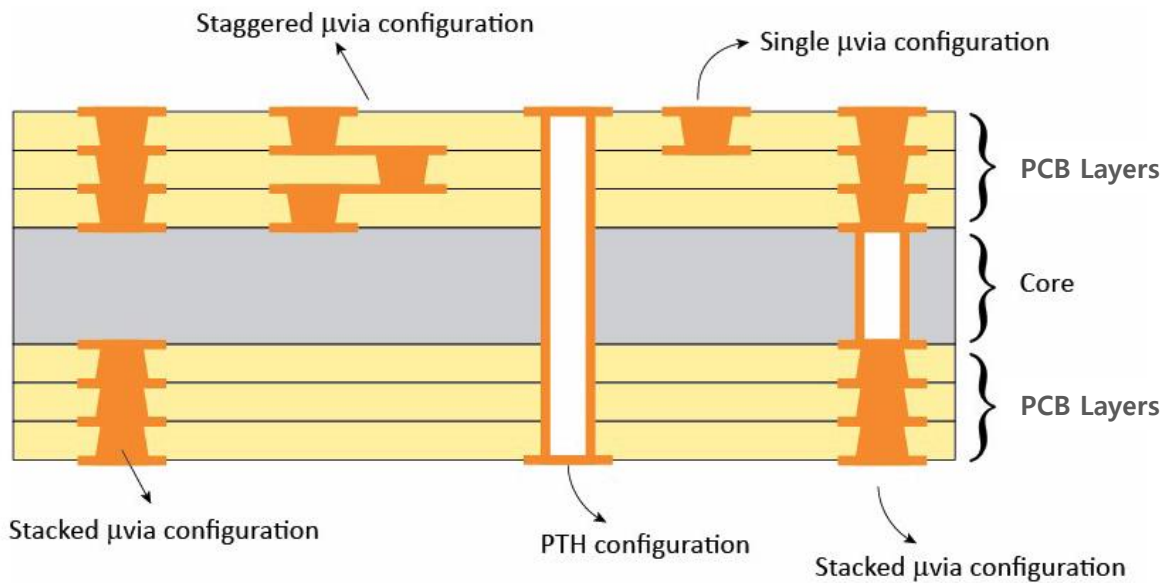
# Products Introduction – Copper Plating Chemical

최종표면처리

동도금

Process Chemical

Electronic Materials



Finish Plating

Copper Plating

Process Chemical

Electronic Materials

PCB 생산공정 및 전자부품소재 공정에 사용되는 화학소재로 당사는 DRY FILM에 사용되는 박리제부터 플렉스 세정제에 이르는 다양한 화학소재 제품을 보유하고 있습니다.

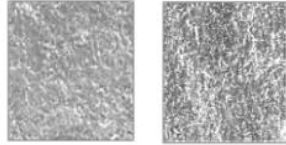
DR Series (박리)



- ✓ 고객사별 제품 특성에 맞는 박리제 보유
- ✓ 빠른 박리효과 및 높은 수율

SE Series (소프트 에칭)

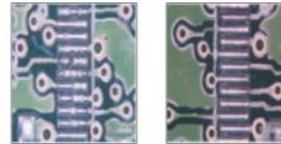
Before After



- ✓ 균일한 Copper 조도 형성 가능
- ✓ D/F 및 PSR 밀착력 상승을 통한 높은 수율 확보

Gold Recover

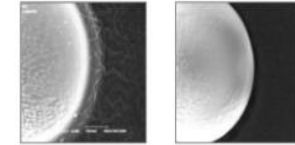
Before After



- ✓ 표면처리 후 금 표면의 오염물질 제거
- ✓ 타사 대비 오염물질 세정능력 매우 우수

Cleaner

Before After



- ✓ 디플렉스 세정액으로 수계, 유기계 2가지 Type
- ✓ 장비 내의 먼지를 제거 시켜 불량률 감소
- ✓ 메탄올 등 유해물질 없이 친환경 제품으로 공급

Finish Plating

Copper Plating

Process Chemical

Electronic Materials

세계 최초로 무전해화학동 공법을 이용하여 생산된 당사의 극동박은 EMI 차폐, FCCL, 방열 필름등으로 다양하게 활용이 가능하며, 외산이 점유하고 있는 시장에서 높은 매출성장이 기대됩니다.

RTR 생산 설비



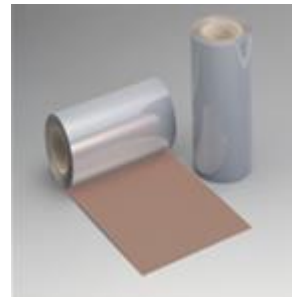
- ✓ 모재를 회전롤에 감으면서 약품을 도포하여 동박을 생산 하는 설비
- ✓ 현재 월 15,000m<sup>2</sup> Capa.

극박형 동박



- ✓ EMI 차폐와 FCCL의 원소재가 되는 동박으로 2um~6um 정도의 매우 얇은 극박
- ✓ 세계최초 무전해화학동 기법으로 생산된 동박

EMI 차폐 Sheet



- ✓ 알루미늄 캐리어와 동으로 구성된 동박 형태
- ✓ 전자파 차단과 방열 소재로 향후 성장이 매우 기대되는 전자소재

PET CCL



- ✓ 당사의 동박을 이용하여 제작된 FCCL
- ✓ 향후 기판의 경박단소화가 트렌드로 대두되어, 성장이 예상됨

For 5G Technology

Nanotus®

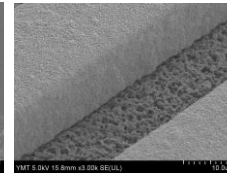
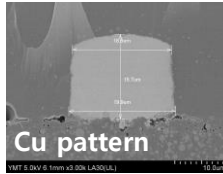
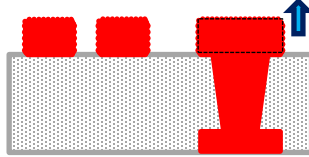
Non etching & Ultra low fine profile pretreatment Nanotus®  
PSR pretreatment, Lamination pretreatment For High frequency application.



New Products for 5G technology

Nanotus®

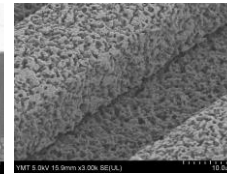
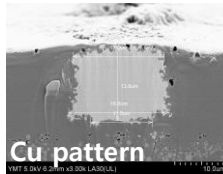
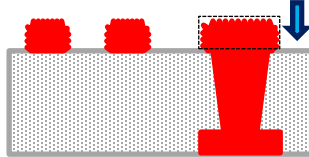
Growing sub-micro tooth



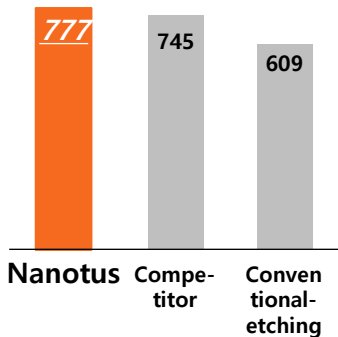
Extremely low profile:  $R_a \sim 0.15 \mu m$ ,  $R_z \sim 0.35 \mu m$

Conventional etching

Etching Cu to form tooth

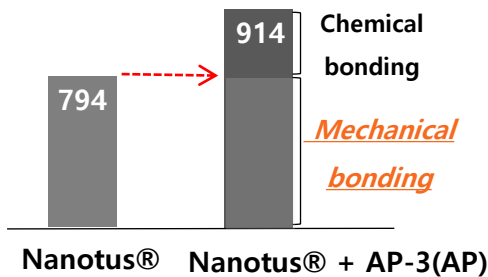


Peel strength with PSR (g/cm)

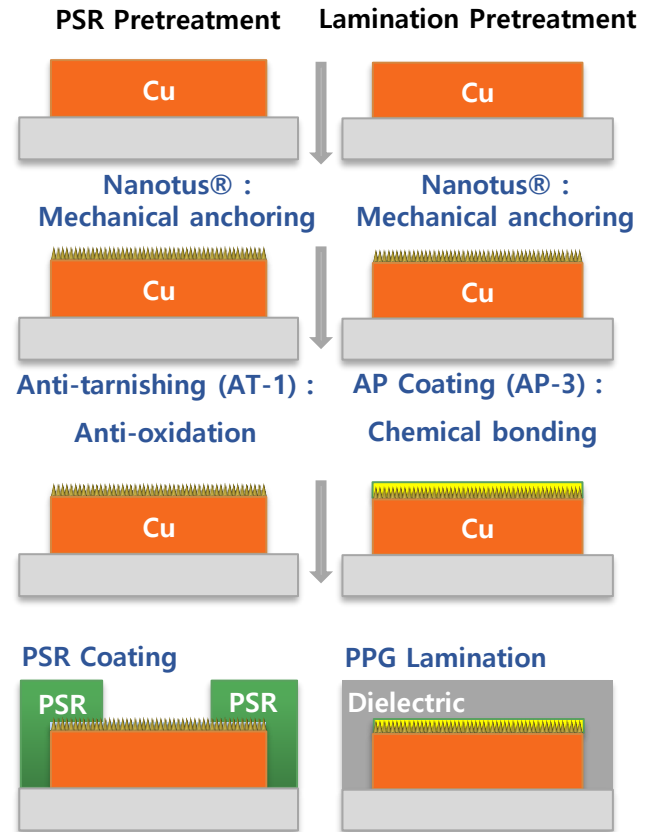


Peel strength with Pre-preg (g/cm)

1 oz-Cu foil, DS-7402



Process of Nanotus



## Foam Sponge thin copper foil for 5G high frequency EMI shield film

Production Technology : Hybrid Copper plating on metal carrier

Available Copper foil Thickness : 2 ~ 6um

Porosity Rate : < 20%

Over 80db of Db of excellent EMI effectiveness under 5G Frequency 10~28GHz

Excellent electrical properties

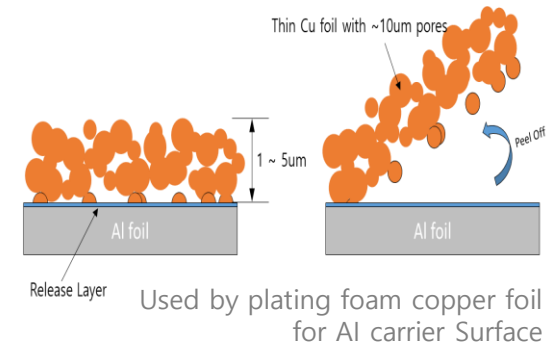
Most effective heat-resistance on high-temperature



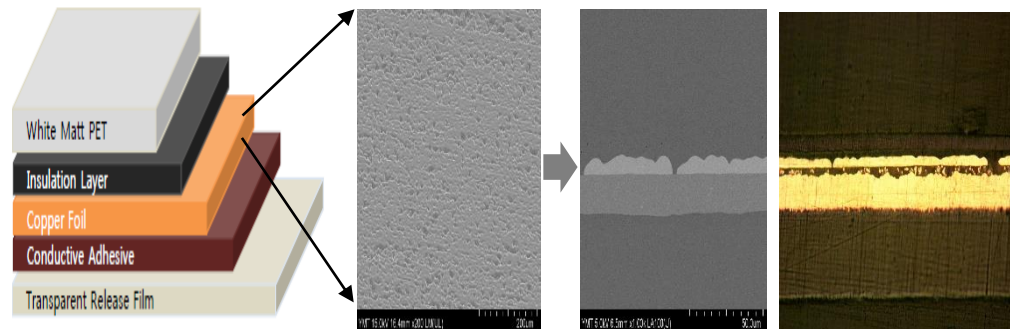
### Thin Copper Foil for 5G

#### Property & Strength

- Improvement of heat resistance
  - Reflow : > 265°C
  - Solder float : > 300°C
- Surface Roughness : < Ra 0.5um
- Thickness uniformity : < ±3%
- Shielding Effectiveness(over 10GHz) : >80dB
- Signal loss rate : < -8%
- Peel Strength >1.0kgf / cm



#### Core Technology [Structure & Characteristics]



- Foam sponge thin cu foil material used in high frequency EMI shielding materials
- Excellent electrical properties and thermal resistance
- Signal transmission speed is excellent and signal loss rate is low

Domestic Market situation

신규 사업분야  
기존 사업분야

|                  |             | "기존 사업영역"<br>FPCB, RFPCB  |  | "20년 신규진입분야"<br>PKG   |   | HDI |  | RIGID |  |
|------------------|-------------|---|--|---|---|-----|--|-------|--|
| Major player     | Domestic    | <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMCO</li> <li>BH Flex</li> <li>Youngpoong</li> <li>Daeduck</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMCO</li> <li>Daeduck</li> <li>SIMTECH</li> <li>Korea Circuit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Daeduck</li> <li>LG Innoteck</li> <li>Korea Circuit</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyunwoo</li> <li>SEIL</li> </ul> |     |  |       |  |
|                  | Global      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zhending Technology</li> <li>Career</li> <li>Unimicron</li> <li>Mektron</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>AT&amp;S</li> <li>Zhending Technology</li> <li>Ibiden</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>AT&amp;S</li> <li>Zhending Technology</li> <li>Ibiden</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Various</li> </ul>               |     |  |       |  |
| Process Chemical |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>점유율 확대중</li> <li>Fine pattern 용 고부가가치 박리액 등 프로모션</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>19년 하반기 Major 고객사 첫 납품 시작으로 진입</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>박리 / 에칭 관련 매출 확대중</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>                     |     |  |       |  |
| Cu Plating       | Electroless | <ul style="list-style-type: none"> <li>국내 높은수준의 점유율 보유 (40% 이상 추정)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>자회사 외주를 통한 매출발생</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>국내 HDI 업체 프로모션 중</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>                     |     |  |       |  |
|                  | Electro     | <ul style="list-style-type: none"> <li>외주를 통한 양산</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>                     |     |  |       |  |
| 최종표면처리           | Electroless | <ul style="list-style-type: none"> <li>금도금 분야 전세계 1위 점유율 확보 (50%이상)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>고객사 평가중</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>일부 국내 고객사 거래중</li> </ul>         |     |  |       |  |
|                  | Electro     | <ul style="list-style-type: none"> <li>자회사 외주를 통한 일부 매출 발생</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>            |     |  |       |  |



2020 Business 전망

Market Forecast

- 카메라모듈용 PCB 생산물량 지속 증대
- 북미 A社 및 중국 스마트폰 제조사의 OLED 채택 모델 증가
- 5G 적용에 따른 신규 프로세스 도입 니즈 확대
- 국내 PKG Substrate 호황기 전망

|          | 최종표면처리(금도금)  | 동도금 화학소재  | Process Chemical  | 기판가공 & 신사업   |
|----------|--|---|---|--|
| Domestic | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>OLED 탑재 모델 증가에 따른 한국 FPCB 제조사 물량 증가</b></li> <li>✓ 국내 카메라 모듈 증대에 따른 약품 소모 증가</li> <li>✓ FPCB를 넘어서 PKG Substrate의 금도금 시장 진입 시도</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ OLED RFPCB 적용 동도금 (MJH시리즈) 물량 확대</li> <li>✓ <b>FPCB, RFPCB용 비아필 전기동도금 시장 진입</b></li> <li>✓ <b>PKG Substrate 기판용 무전해화학동도금 런칭</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FPCB, RFPCB 미세회로 패턴용 회로공정 약품 프로모션 강화</li> <li>✓ <b>19년 하반기 런칭한 PKG Substrate 기판용 약품의 확판</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 카메라모듈용 기판외주가공 물량의 지속 유지 (YPT)</li> <li>✓ 비아필 전기동도금 외주가공 물량의 확대 (YPT)</li> <li>✓ <b>하반기 폴더블 플래그쉽 모델 5G EMI용 동박 양산</b></li> </ul> |
| Global   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>중국 LOCAL 고객사의 카메라 모듈 확판에 따른 ENEPIG 물량 확대</b></li> <li>✓ 베트남 현지 고객사 가동률 및 한국 업체의 이전 확대에 따른 매출 성장</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 베트남 시장 무전해 화학동도금 매출 확대 (삼성전기, 비에이치 등)</li> <li>✓ 20년 말 동도금약품 중국시장 런칭 및 현지 제조</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 베트남 및 중국 현지 업체 대상 회로공정 약품 프로모션</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 중국 Local 업체 대상 5G EMI용 프로모션 강화, 중국 현지업체와 NDA 계약 후 판매 진행</li> <li>✓ 베트남 현지 FPCB 금도금 외주가공 매출 확대</li> </ul>                        |

2020 CAPEX 주요 예정사항

**극동박**  
**제조설비 증설**

- EMI Shield 기초소재, 국내 S社 向 납품 진행 및 중화권 업체 관심도 증가
- 1차 증설규모 : 7 만㎡ (월) / 현재는 RTR 외주와 라인을 공용으로 사용 중으로 Capa. 부족
- 대상지역 : 경기 안산
- 1차 투자규모 : 약 30억 예상, 현재 완공으로 8월 시험가동중

**중국법인**  
**Chemical**  
**제조공장 설립**

- 중화권 고가 소재시장 점유율 대비 일반약품 시장 점유율 약세
- 중국 內 생산/판매를 통한 일반약품 시장에서의 가격경쟁력 강화 및 물량이 큰 화학동도금 약품 생산
- 대상지역 : 주하이 지역 약 4,000평 부지 확보, 연내 공장 착공 예정
- 총 투자규모 : 약 70억원 예상

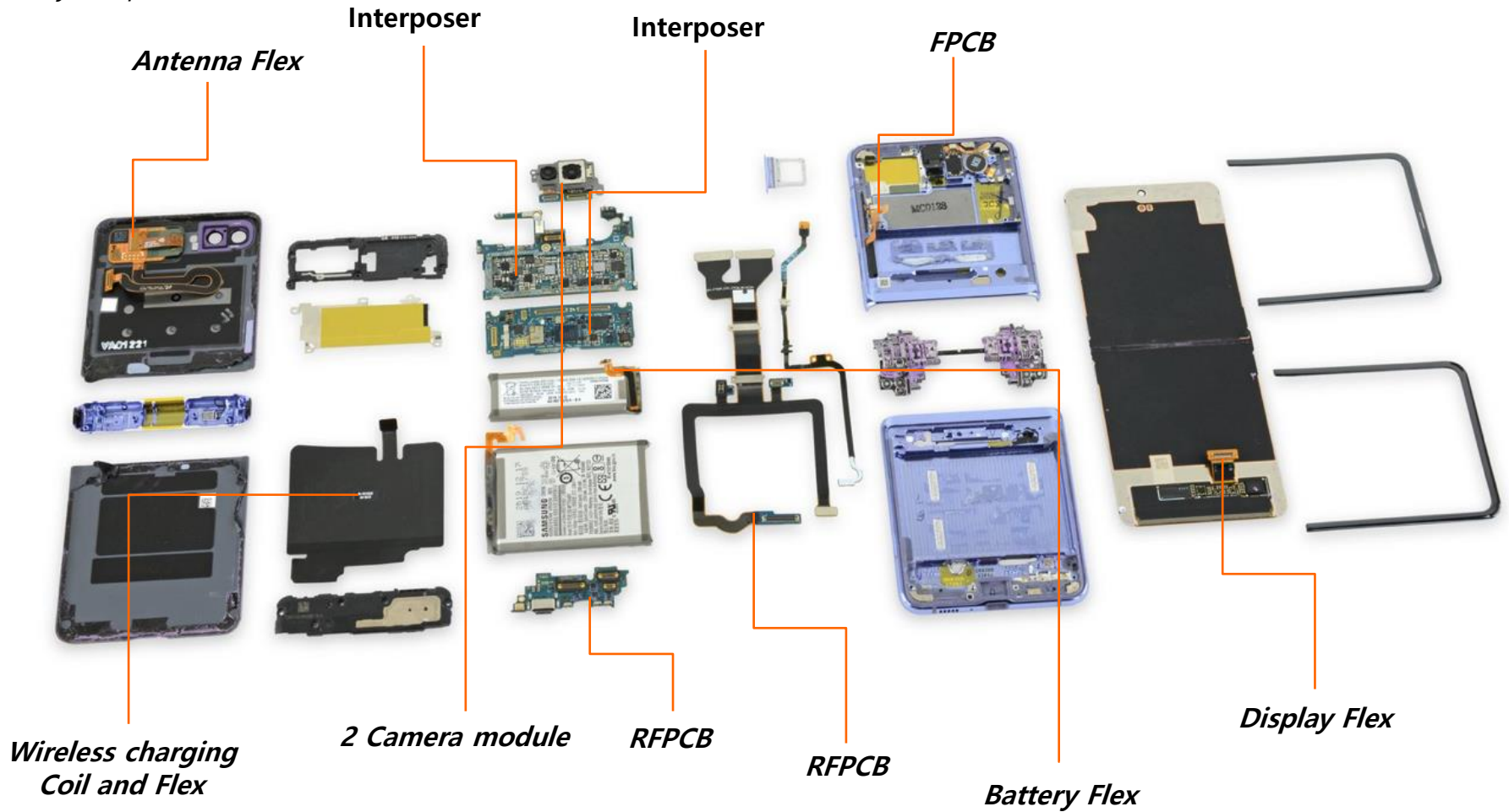
**베트남법인**  
**도금라인 증설**

- 국내 고객사의 생산거점 이전으로 인한 베트남 현지 외주가공 물량 증대 예상
- 현재 금도금라인 2개 set-up 완료, 1개 라인 setting 중
- 현지 외주도금 수요량 예측을 통해, 추가 도금라인 증설 검토 중
- 추가 투자규모 : 약 20억원

**반도체 PKG용**  
**Chemical**  
**제조설비 증설**

- PKG용 소재 고객사 공급규모 증대 예상
- 현재 소규모 클린룸 및 제조설비 가동 중
- 고객사 공급물량 확대 시 클린룸 확장 및 설비 증설 검토
- 추가 투자규모 : 약 30억 예상

*Galaxy Z flip teardown*



디스플레이 확대에 따른 배터리 면적 증가로 기존 하나의 HDI가 여러개의 HDI 및 RFPCB 로 형태가 변경됨,  
RFPCB의 채용 증가가 두드러지는 변화이며, 향후 이러한 트렌드는 계속될 전망

Applications

*i Phone 11 pro teardown*



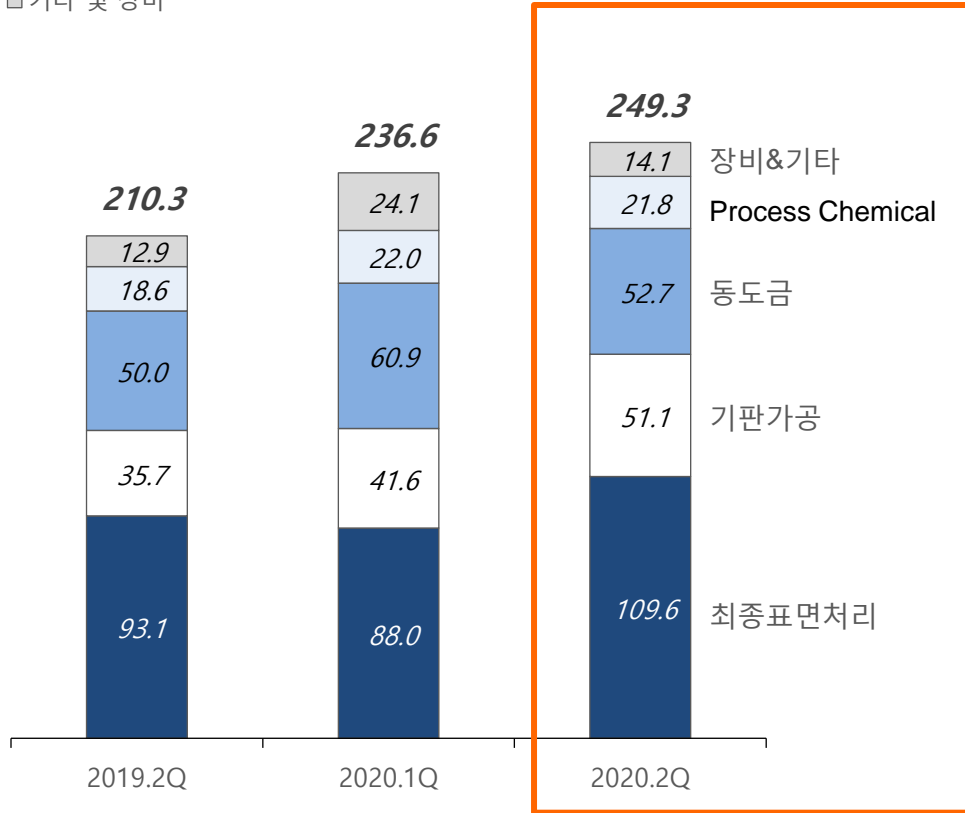
*Airpod Pro Teardown*



Galaxy와 마찬가지로 Apple의 모델 또한 배터리의 면적 확대로 다양한 RFPCB 모듈을 탑재하고 있으며, 블루투스 이어폰 같은 모바일 악세사리 역시 고 기능성의 RFPCB 탑재가 트렌드로 대두됨

Sales Result

■ 최종표면처리[금도금]    □ 기판가공    (단위: 억원)  
■ 동도금    □ Process Chemical  
■ 기타 및 장비



- 20년 2분기 249.1억원 역대 최대 매출 달성
  - ✓ 19년 동기대비 210.3억원 대비 18.4% 매출 상승
- Chemical 제품군의 지속적인 성장
  - ✓ 최종표면처리 : 중국 시장 카메라모듈용 도금약품의 매출확대 / 특히 최대 고객사인 대만계 ZDT를 통하여 북미 보급형 모델에 적용중
  - ✓ 동도금 : 북미 고객사 무선이러폰 물량 증가 및 베트남 내 동도금 약품 점유율 확대
  - ✓ 기판가공 : 베트남 외주도금 물량 확대, 국내 동도금 외주물량 증가
  - ✓ Process Chemical : Substrate PKG 고객사 진입으로 인한 전년 동기 대비 매출 상승

Income Statement

(단위:억원)

|              | 제 22기 반기     | 매출비중  | 제 21기 반기 | 매출비중  |
|--------------|--------------|-------|----------|-------|
| I. 매출액       | <b>485.9</b> | 100%  | 388.6    | 100%  |
| II. 매출원가     | <b>314.8</b> | 64.8% | 240.0    | 61.8% |
| III. 매출총이익   | <b>171.1</b> | 35.2% | 148.6    | 38.2% |
| 판매비와 관리비     | <b>72.1</b>  | 14.8% | 53.5     | 13.8% |
| IV. 영업이익     | <b>99.0</b>  | 20.4% | 95.1     | 24.5% |
| 금융수익         | <b>26.3</b>  | 5.4%  | 10.2     | 2.6%  |
| 금융비용         | <b>14.0</b>  | 2.9%  | 5.6      | 1.4%  |
| 기타수익         | <b>2.0</b>   | 0.4%  | 7.9      | 2.0%  |
| 기타비용         | <b>1.1</b>   | 0.2%  | 7.1      | 1.8%  |
| 지분법손익        | <b>-0.9</b>  | -0.2% | 0.1      | 0.0%  |
| V. 법인세차감전순이익 | <b>111.3</b> | 22.9% | 100.5    | 25.9% |
| 법인세비용        | <b>8.5</b>   | 1.8%  | 22.1     | 5.7%  |
| VI. 당기순이익    | <b>102.8</b> | 21.2% | 78.5     | 20.2% |

주요 수익성 지표

|                 | 22기 반기           | 21기 반기           |
|-----------------|------------------|------------------|
| 영업이익률           | 20.4%            | 24.5%            |
| 순이익률            | 21.2%            | 20.2%            |
| EBITDA<br>(마진율) | 127.4<br>(26.2%) | 117.6<br>(30.3%) |
| 총자산회전률          | 28.8%            | 28.9%            |

## Balance Sheet

(단위:억원)

|             | 제 22기 반기       | 제 21기          |
|-------------|----------------|----------------|
| 자산          |                |                |
| 현금성자산       | 540.8          | 417.5          |
| 매출채권        | 231.8          | 264.7          |
| 유형자산        | 630.2          | 608.6          |
| 기타자산        | 333.5          | 348.5          |
| <b>자산총계</b> | <b>1,736.3</b> | <b>1,639.3</b> |
| 부채          |                |                |
| 매입채무        | 48.9           | 33.0           |
| 차입금         | 321.6          | 344.7          |
| 전환사채        | 146.4          | 140.4          |
| 기타부채        | 144.5          | 216.9          |
| <b>부채총계</b> | <b>661.4</b>   | <b>735.0</b>   |
| 자본          |                |                |
| 자본금         | 37.0           | 37.0           |
| 자본잉여금       | 263.1          | 218.6          |
| 이익잉여금       | 608.5          | 531.3          |
| 기타자본        | 166.3          | 117.4          |
| <b>자본총계</b> | <b>1,074.9</b> | <b>904.3</b>   |
| 부채와 자본계     | 1,736.3        | 1,639.3        |

## Cash Flow

(단위:억원)

|                | 제 22기 반기 | 제 21기 반기 |
|----------------|----------|----------|
| 기초현금           | 417.5    | 276      |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 172.1    | 64.8     |
| 순이익            | 102.8    | 78.5     |
| 감가상각비          | 23.1     | 18.3     |
| 대손상각비(환입)      | -1.5     | -11.3    |
| 이자비용           | 10.1     | 5.1      |
| 법인세비용          | 8.5      | 22.1     |
| 외화환산이익         | -5.1     | -4.4     |
| 자산부채의 변동       | 49.8     | -37.4    |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -48.1    | -51.8    |
| 유형자산의 증가       | -43.3    | -52.9    |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -4.9     | 15.6     |
| 자기주식의 처분       | 21.7     | 0        |
| 차입금 증감         | -23      | 19.8     |
| 현금증감           | 119.1    | 28.6     |
| 환율변동효과         | 4.2      | 5.5      |
| 기말현금           | 540.8    | 310.1    |

END OF DOCUMENT

---

감사합니다.